



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

堆叠高度: 9.2 mm [ .362 in ]

模块方向: 直角

PCB 安装方式: 表面贴装

连接器系统: 缆到板

产品特性

产品类型特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| DRAM 类型   | 双倍数据速率 (DDR) 3 |
| 连接器系统     | 缆到板            |
| Sealable  | 否              |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板          |
| 产品类型      | 插座             |

结构特性

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 托架数                 | 2   |
| 中心钥匙                | 右偏移 |
| 钥匙数                 | 1   |
| 模块方向                | 直角  |
| Number of Positions | 204 |
| 行数                  | 2   |
| 键控                  | 反向  |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| DRAM 电压 | 1.5 V |
|---------|-------|

信号特征

|          |       |
|----------|-------|
| SGRAM 电压 | 1.5 V |
|----------|-------|

主体特性



|        |       |
|--------|-------|
| 弹射器位置  | 两端    |
| 插销材料   | 不锈钢   |
| 插销电镀材料 | 锡     |
| 模块钥匙类型 | SGRAM |
| 弹射器类型  | 锁定    |
| 连接器外形  | 反向    |

接触件特性

|                |                |
|----------------|----------------|
| 插座种类           | SO DIMM        |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 金              |
| 端子基材           | 铜合金            |
| 端子接触部电镀材料      | 金              |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .76 µm[30 µin] |
| 端子额定电流（最大值）    | .5 A           |
| 插座类型           | 内存卡            |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 插入种类 | 凸轮 |
|------|----|

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| PCB 安装固定   | 带有   |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉   |
| PCB 安装方式   | 表面贴装 |
| 连接器安装类型    | 板安装  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | .6 mm[.024 in] |
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 高温热塑性塑料        |

尺寸

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 堆叠高度               | 9.2 mm[.362 in] |
| Row-to-Row Spacing | 8.2 mm[.322 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |                |
|------|----------------|
| 封装方法 | Emboss on Reel |
| 封装数量 | 150            |

其他

|    |        |
|----|--------|
| 注释 | 带浮动销钉。 |
|----|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2309407-1  
DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD

该系列中的其他产品 | Raychem RVS

RJ45 连接器(1)

SD 卡连接器(2)

SO DIMM 插槽(13)

接头和拼接件(4)

客户还购买了

TE 产品编号2-2199154-1  
DDR4 DIMM 插槽

TE 产品编号2-1658062-3  
MSB0.80RC-ASY120FL,-,10,-TY

TE 产品编号2007881-3  
IMP100S,H,V6P10C,UG,LEW46,5.5

TE 产品编号1-6450161-5  
MBXL R/A RCPT 12S+4P

TE 产品编号2-1734774-1  
PCI EXP 3.1L 98 POS WHT 30u"

TE 产品编号2-1734774-3  
PCI EXP 3.1L 164 POS WHT 30u"

TE 产品编号2-2013290-3  
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H RVS  
Au 0.76

TE 产品编号3-1775099-2  
ATX PWR CONN 1 BDLK 8 POS

TE 产品编号3-1775099-3  
ATX PWR CONN 1 BDLK 10 POS



文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2013311-3\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2013311-3\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2013311-3\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_2-2013311-3\_08212017647\_dmtec

英文版本

MD\_2-2013311-3\_08212017647\_dmtec

英文版本